

SPUTTERING TARGET

各種製法による多種類のターゲット材に対応



形状(製法)	特徴	実績
円筒(ボンディング)	<ul style="list-style-type: none"> 高密度材で緻密な膜 特殊ボンディング材使用 	Al,Si,Ti,Nb,Cr,Ta,Mo,Zn、ITO その他合金類
円筒(一体型)	<ul style="list-style-type: none"> ボンド材が無いので高入力可 	Al,Ti
円筒(溶射)	<ul style="list-style-type: none"> 成膜レートが早い 大型ターゲット可能(~L4000mm) 	Al,Si,Nb,Cu,Ag,Cr その他合金類
平面(ボンディング)*	<ul style="list-style-type: none"> 高密度材で緻密な膜 特殊ボンディング材使用 矩形、円板、段差等各種形状可 	Al,Si,Ti,Cr,ITO,Nb,Ni,Hf,Ag,Fe, その他合金類

*平面ターゲットの一体型も製造可能

バックングプレートの製造も承ります (~ L4000mm)

株式会社ソルテック

〒110-0005 東京都台東区上野 3-23-11 松田ビル 4F

TEL : 03-5812-1813 FAX : 03-5812-0370